

# SURTECH

## 表面技術要素展

2026年12月16日(水)~18日(金)  
東京ビッグサイト 南1ホール&会議棟

主催: (一社)表面技術協会、日本鍍金材料協同組合  
(株)JTBコミュニケーションデザイン

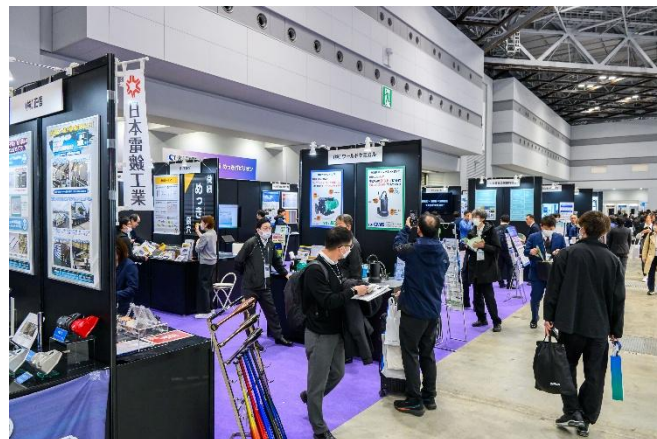
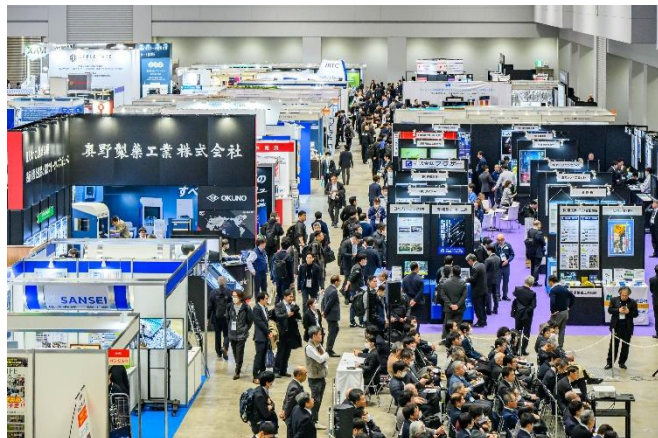
後援: (一社)日本表面処理機材工業会、全国鍍金工業組合連合会

出展プランご案内  
電子部品・半導体パビリオン

# SURTECH 表面技術要素展とは

半導体・電子部品から、自動車、エネルギー、医療まで  
あらゆる産業分野に対応した**表面処理・加工技術の展示会**

SURTECHは、めっきを中心とした、表面処理資機材、加工技術、  
表面処理薬品、熱処理、表面改質などものづくりに不可欠な表面技術全般を取扱う展示会です。



# 前回2026年1月 開催報告

## 会期/会場

2026年1月28日(水)~1月30日(金)

10:00~17:00

東京ビッグサイト 南3・4ホール、会議棟

## 来場者数

同時開催展・オンライン参加含む

来場登録者数  
**52,884** 名  
(同時開催展・オンライン参加含む)

## 東京ビッグサイト来場者

1/28(水) ☁ 12,903 名

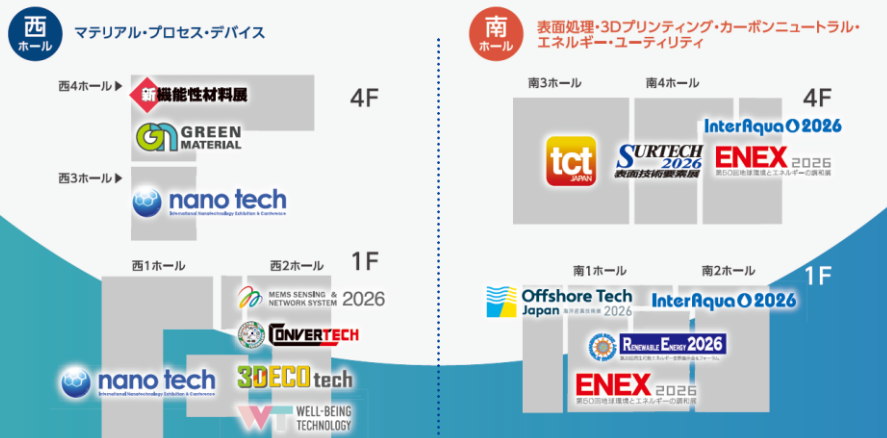
1/29(木) ☁ 15,574 名

1/30(金) ☀ 16,725 名

3日間合計 : 45,202 名

## 同時開催展・ホール配置

【約1,500社出展】ものづくりの未来がここに集結! ※一度の登録で[全展示会]入場可  
素材・加工・装置・エネルギー・インフラ — 業界を横断する13展示会



## 出展者数

SURTECH  
開催規模

129  
社・団体

128  
小間

同時開催展  
含む全体規模

1,449  
社・団体

2,040  
小間

# 前回2026年1月 来場者職種・業種

※SURTECH 2026来場者登録データ。有効回答数2,961件

研究・開発  
 経営者・役員  
 生産・製造  
 開発設計・商品企画  
 品質・技術管理・検査

**62.8%**  
 (+0.3%)

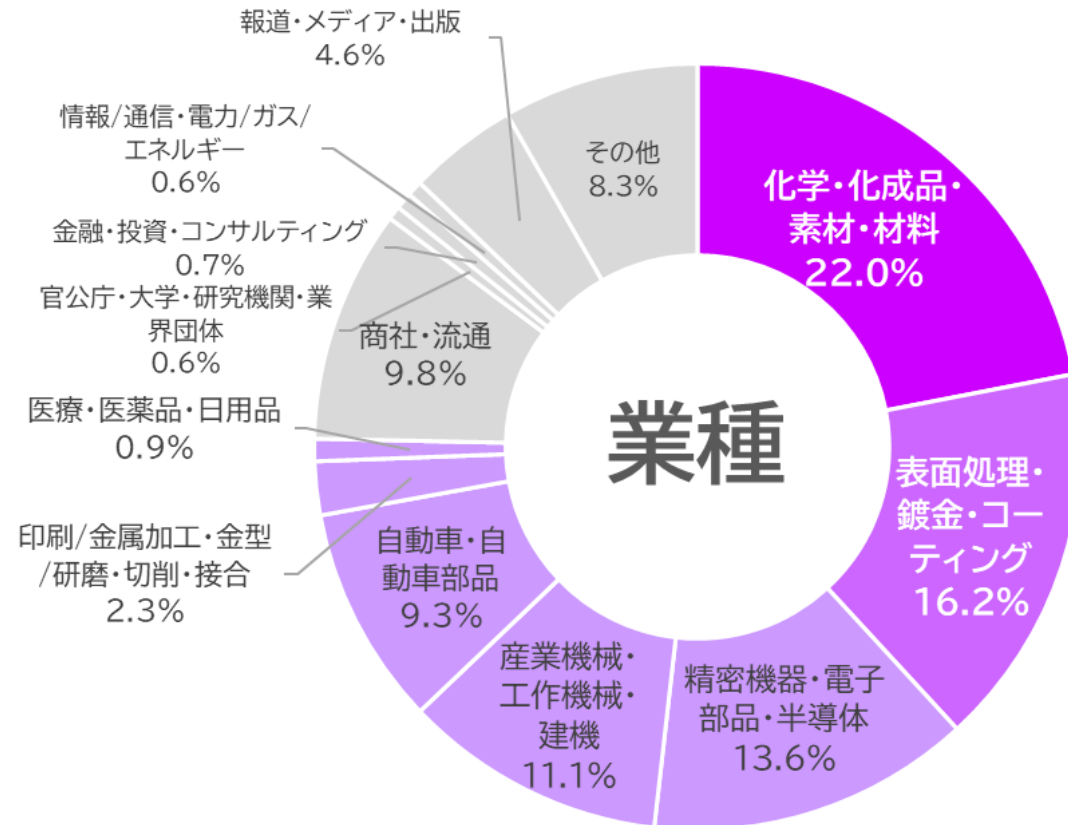
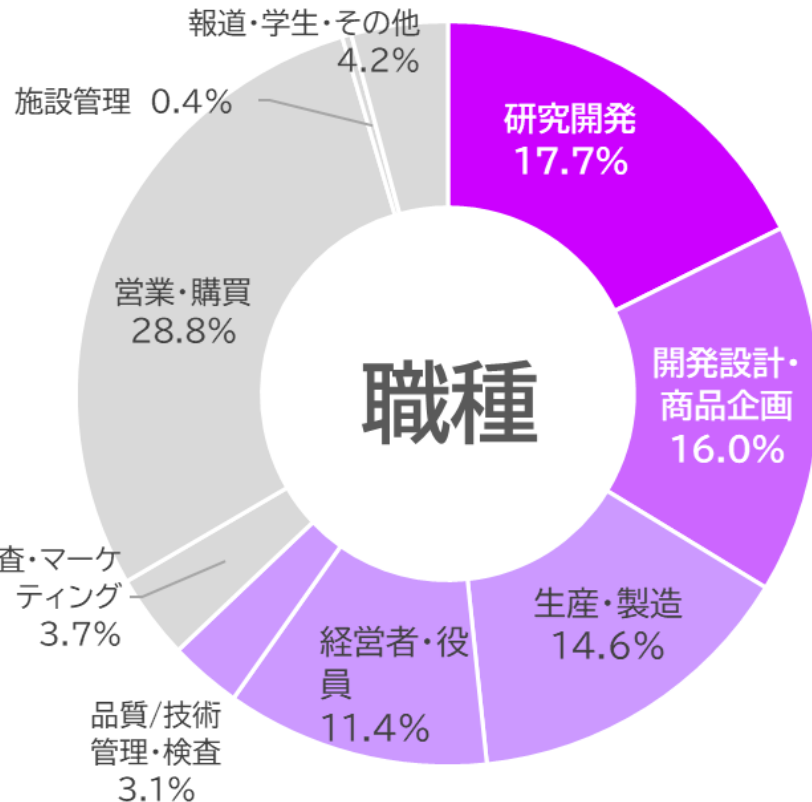
めっき・表面処理專業

**16.2%**  
 (▲0.5%)

化学・材料  
 精密機器・電子部品・半導体  
 自動車・自動車部品  
 産業機械・工作機械

**59.2%**  
 (+3.2%)

※()内は前年比%



# 出展要項

最大 10 社 (予定)

ブース備品付きプラン

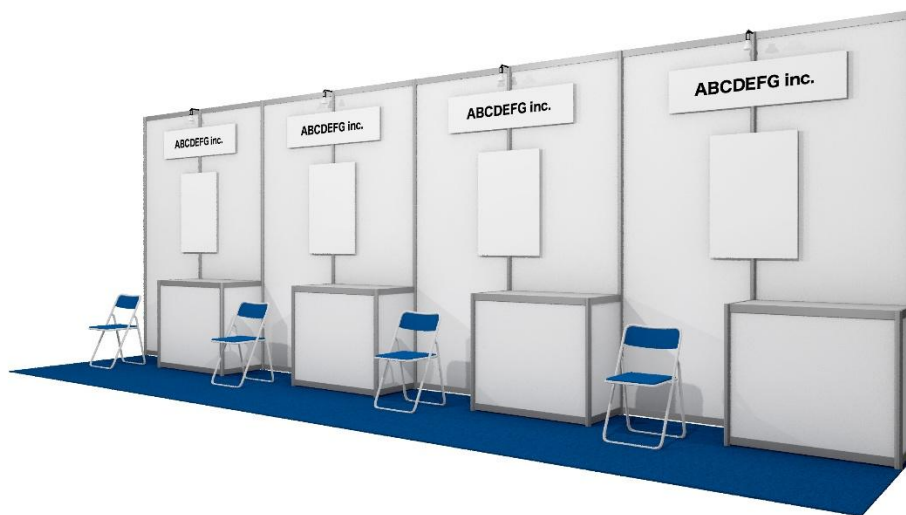
## 電子部品・半導体パビリオン 参加企業限定 パッケージプラン

特別価格

**220,000円 (税別) / 1ブース** ※242,000円 (税込) ※1社最大2ブースまで

### ミニブース 付帯部品

- 壁面システムパネル (W990 × H2700) × 2
- 社名板 × 1
- 床面パンチカーペット
- スポットライト × 1灯
- 展示台 (W990 × D700 × H900) × 1
- パイプイス × 1脚
- 2口コンセント × 1
- 一次幹線電気工事500W



※寸法は変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

※壁面と展示台が一体型のブースになります。

※上記以外の追加備品は別途出展者が施工会社にお申してください。

追加分は、出展者様のご負担となります。

※展示台には鍵はついておりません。別途追加発注 (有料) 可能です。

※各ブース配置は、主催者にて後日決定の上連絡いたします。

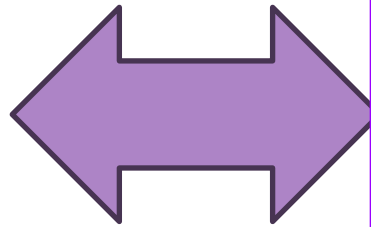
※パンチカーペット色はパビリオン全体の統一感から、主催者にて後日決定いたします。

展示台ではサンプルやカタログ展示、PC・モニターなどでの動画放映が、展示壁面ではA0サイズ2枚相当の展示が行えます。 ※展示用パネル等は自社にてご用意ください。

## 電子部品・半導体パビリオン in SURTECH

### 出展製品・技術

銅めっき・金めっき・貴金属めっき  
真空蒸着  
スパッタリング  
イオンプレーティング  
CVD・エッチング  
酸化・窒化  
イオン注入  
アニーリング  
CMP(化学機械研磨)  
フォトリソグラフィ  
パッシベーション  
ソルダーレジスト  
シリサイド形成                      など



### 来場者

#### 【業種】

半導体・電子部品  
電気・電子機器・総合電機  
精密機器・産業機械・ロボット  
自動車・運輸  
航空・宇宙  
電子・磁性・金属・無機材  
光学部品・デバイス                      など

#### 【職種】

研究開発／経営者・会社役員／  
生産・製造／開発設計・商品企画  
／品質管理・技術検査                      など

～ 表面処理技術を求めるエレクトロニクス業界と出展者をマッチング ～

# 申込方法

## ● 申込方法

本展示会は仮申込が可能です。公式WEBサイト「出展申込フォーム」よりお申込みください。尚、主催者が出展申込を受領した時点をもって、出展の契約が成立するものとします。また、5月31日までに解約を行わない限り、6月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとし、6月1日以降出展者の判断で取り消しする場合は規約14.記載の解約料の対象となりますので、予めご承知おきください。

### 1 申込締切日：2026年7月31日（金）

※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切しますので、お早めにお申込みください。

### 2 出展料のお支払い：出展本申込後、請求書を発行いたします。

請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。

### 3 出展申込の取消：出展本申込後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと

判断した場合は取消を認め、出展規約の基準で解約料を申し受けます。



出展申込



規約

## 本プランの申込方法について：

○出展申込フォームの以下部分（出展ブース）に、出展料金とブース数をご入力ください

主催者企画ブース

¥

242000

x

1

小間 = ¥242,000

※「連絡欄」にブース名を記入ください。

○出展申込フォーム最下段の以下部分（連絡欄）に、「電子部品・半導体パビリオン 参加企業限定 パッケージプラン」をご入力ください

◆連絡欄（ご要望等）

出展製品・技術  
(予定の範囲で結構です。)

電子部品・半導体パビリオン 参加企業限定 パッケージプラン